

聯茂電子

2022年第二季營運成果

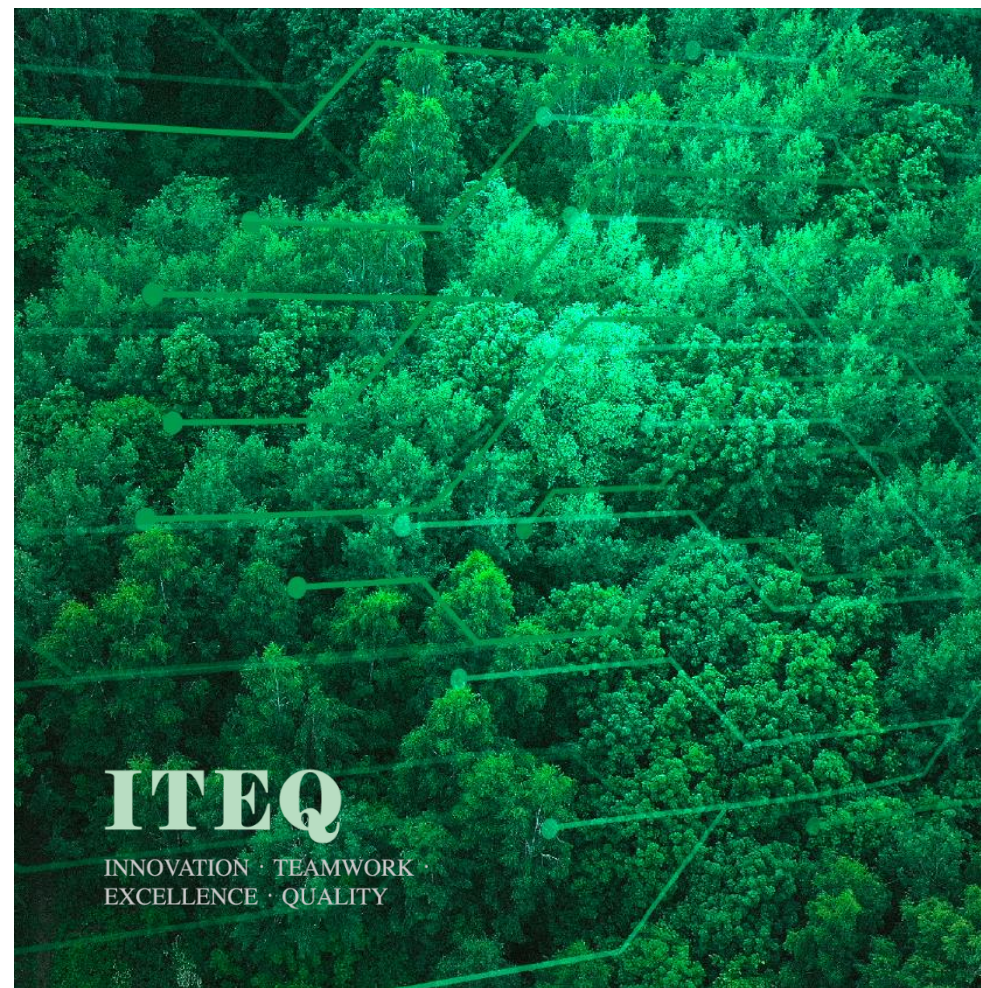
ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

September 2022

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



公司簡介



成立日期
1997年4月10日



總部
臺灣新竹縣



實收資本額
NT\$ 38.3億



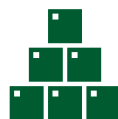
員工
約4,000人



董事長
陳進財

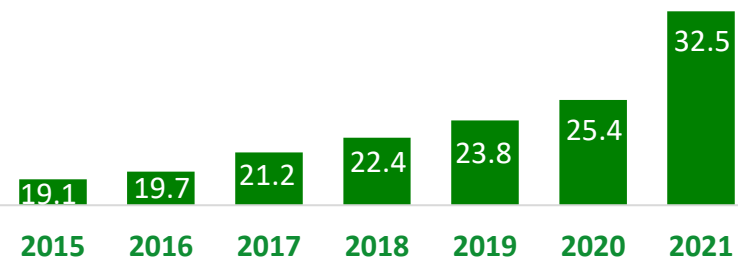


執行長
蔡馨曄

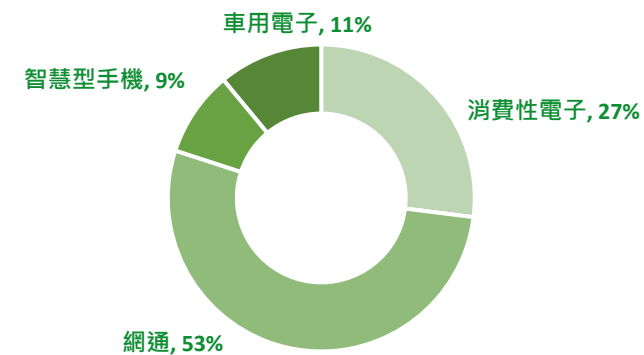


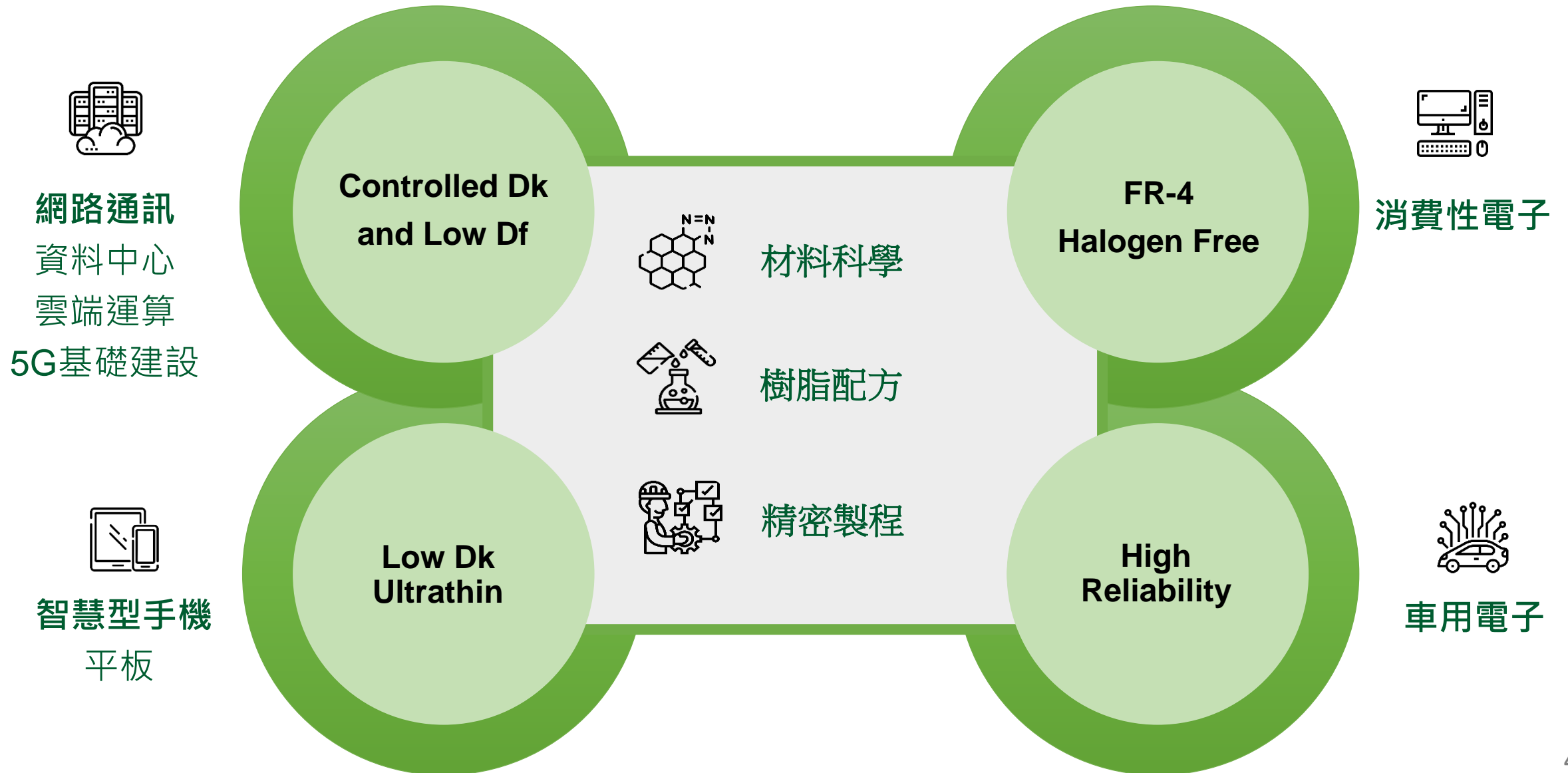
主要產品
銅箔基板 (CCL) & 膠片 (PP) | 多層壓合代工 | 軟性銅箔基板

營收 (NT\$ 十億元)



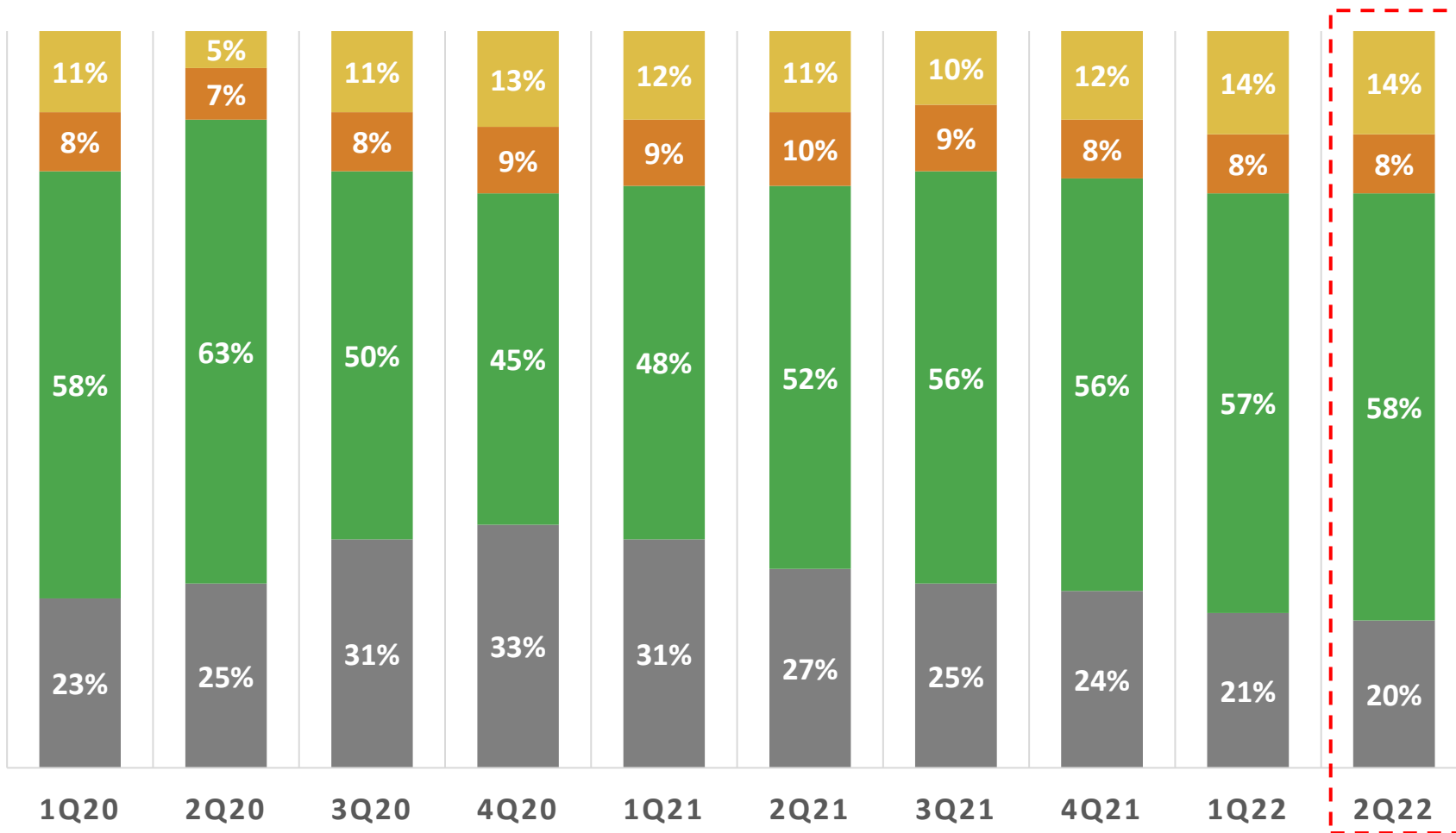
產品應用別營收 (2021全年)





1Q20~2Q22 產品組合

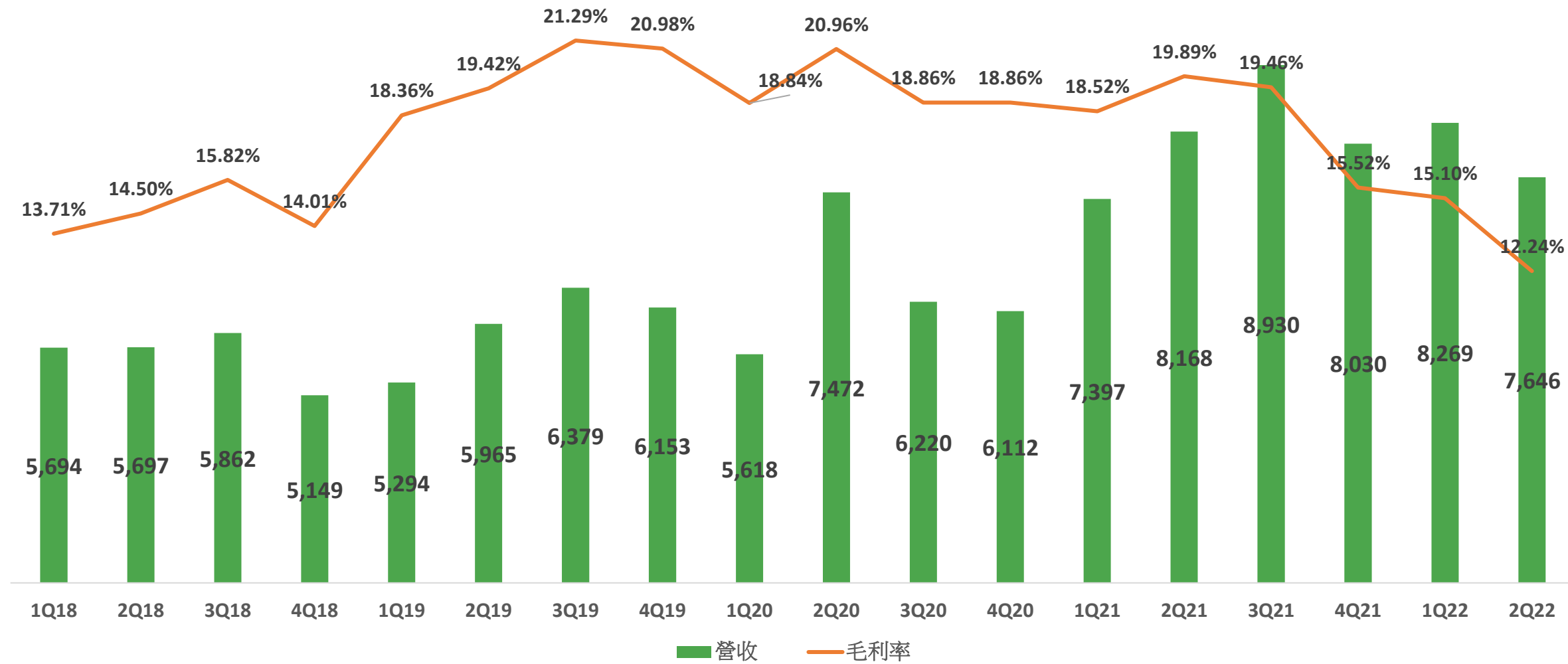
■ 消費性電子
 ■ 網路通訊
 ■ 智慧型手機
 ■ 汽車電子

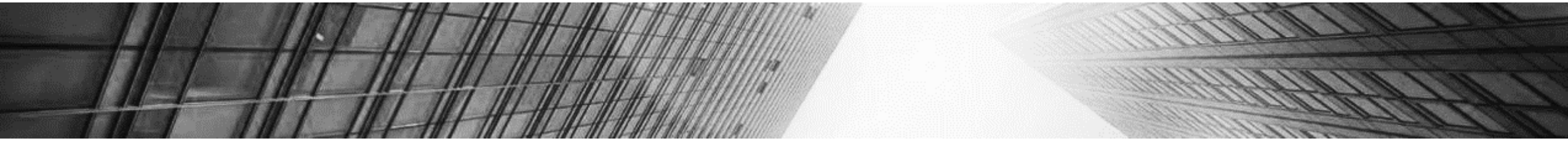


2Q22 產品成長率	QoQ	YoY
汽車電子	-7.5%	+31.1%
智慧型手機	-7.5%	-31.9%
網路通訊	-5.9%	+4.4%
消費性電子	-11.9%	-30.7%

營收 & 毛利率

(百萬 NTD)





成長策略藍圖

ITEQ

廣泛應用於消費性
電子產品



導入車用銅箔基板於
知名國際廠商



提供智慧型手機應
用之銅箔基板



提供伺服器應用之銅
箔基板



成為Intel Purley伺服器
平台主要銅箔基板
供應商



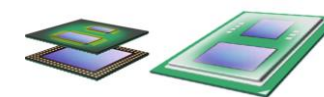
台灣最大5G基地台應
用之銅箔基板供應商



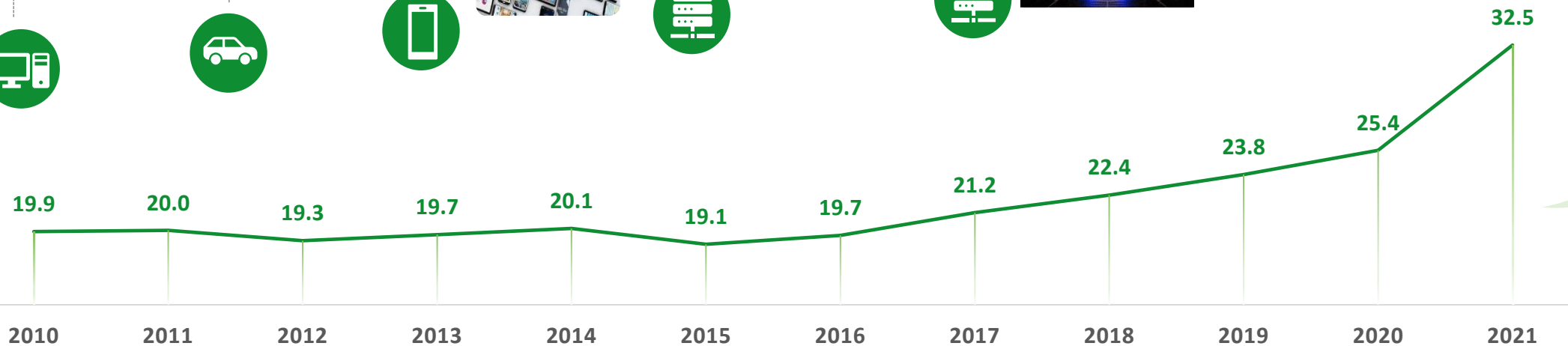
新產品發表 (次世代 HDI
PCB應用): 背膠銅箔 (RCC)



類載板基材 (SLP) &
IC封裝載板基材

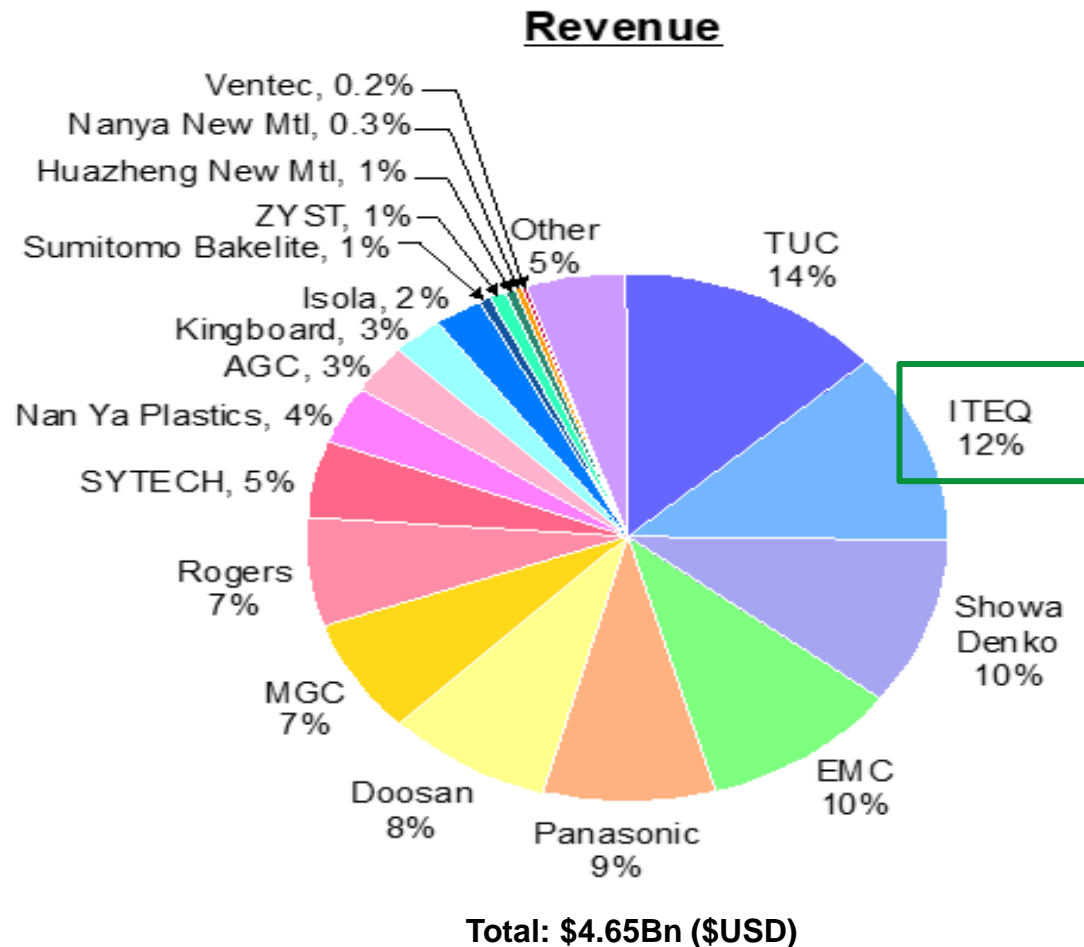


Beyond



— 營收 (NT\$ 十億元)

2021年特殊基板供應商市佔率

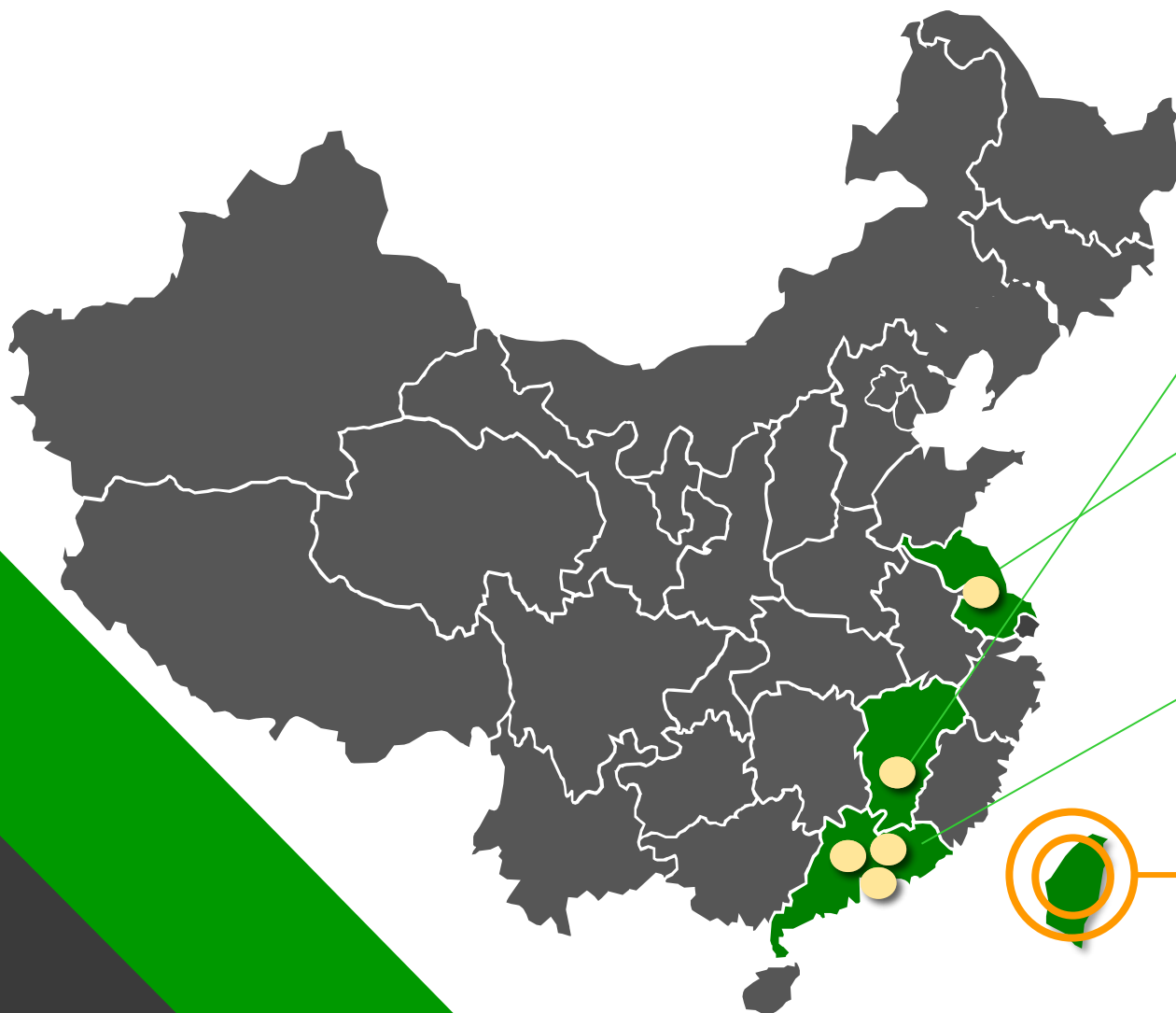


*特殊基板包含: 高速基板、封裝基板、射頻基板
資料來源: Prismark Report, 2022/05

聯茂: 銅箔基板領先供應商

- 全球高速高頻銅箔基板主要供應商
- 先進製程技術和豐富量產經驗
- 5G網路通訊與資料中心商機之長期受惠者
- 電動車市場崛起擴大車用電子對高速高頻材料需求

INNOVATION · TEAMWORK ·
EXCELLENCE · QUALITY



江西廠
(第一期) - 2020
基板 (60萬張/月)
膠片 (350萬米/月)
(第二期) - 2021
基板 (60萬張/月)
膠片 (350萬米/月)
(第三期) - 2022 & 2023
基板 (120萬張/月)
膠片 (500萬米/月)



無錫廠
基板 (165萬張/月)
膠片 (800萬米/月)



東莞廠
基板 (100萬張/月)
膠片 (400萬米/月)



廣州廠
軟板 (145萬平方米/月)

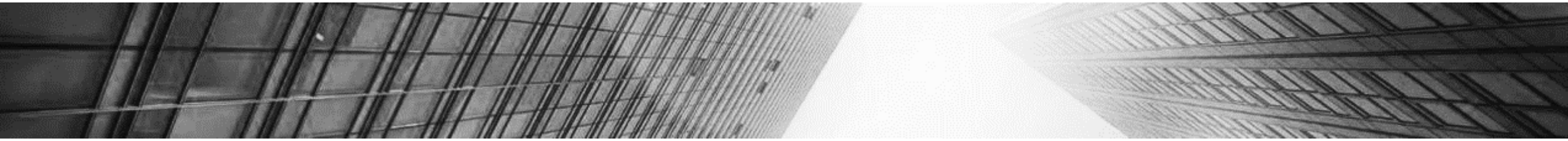


黃江廠
壓合代工 (50萬平方呎/月)



台灣新埔廠 (總部)
基板 (40萬張/月)
膠片 (240萬米/月)

Distributor/Agent: USA, Europe, Israel, Korea, Japan and Singapore



市場趨勢 & 成長動能

ITEQ

Intel	Platform	Purley		Whitley		Eagle Stream	
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Copper Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	14 nm++	10 nm	Intel 7	Intel 7
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	Cancel	2021 Q1	2023 H1	2023
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Cancel	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	Cancel	12 to 16	16 to 20	16 to 20

AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q4
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20



資料中心長期穩定升級將有利予以下；

- 對應設備之基板材料亦同等升規
- 增加銅箔基板消耗量與設計板層數

綠能/電動車



- 節能
- 大電流
- 充電
- 大電壓
- 厚銅

High Tg 材料

車聯網

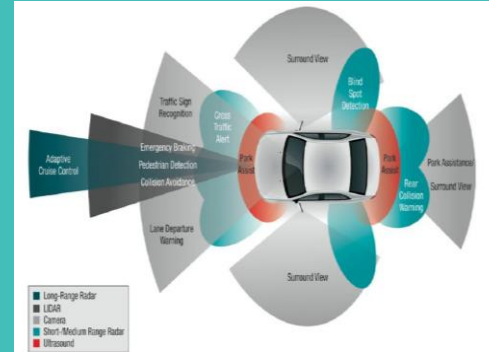


- 車用資訊娛樂
- 網路通訊

HDI 材料

高速材料

主動式安全系統



- 安全駕駛系統
- ADAS (先進駕駛輔助系統)
- 雷達
- 天線模組

高頻材料

高速材料

自動駕駛

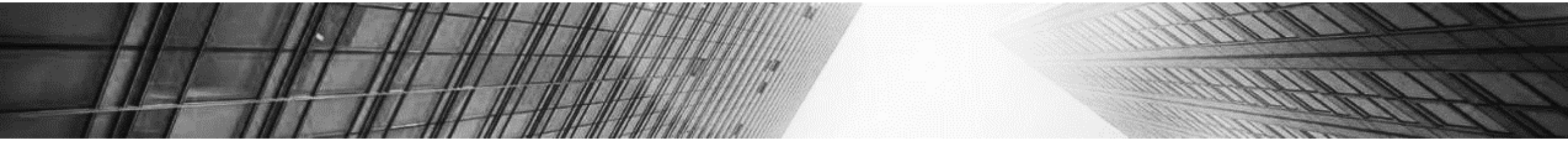


- 車用高速運算
- 影像處理計算
- 自主駕駛控制平台模組

HDI 材料

高速材料

- 電動車、車聯網和主動式安全駕駛系統將推動高性能車用銅箔基板之需求



2Q22 營運成果

ITEQ

ITEQ

INNOVATION • TEAMWORK •
EXCELLENCE • QUALITY

2Q22 損益表

NTD/百萬元	2Q22	1Q22	2Q21	QoQ	YoY
營業收入	7,646	8,269	8,168	-7.5%	-6.4%
營業毛利	936	1,249	1,625	-25.1%	-42.4%
營業費用	486	605	483	-19.7%	0.6%
營業利益	450	644	1,142	-30.1%	-60.6%
營業外收入及支出	146	332	(19)		
稅前淨利	596	976	1,123	-38.9%	-46.9%
所得稅費用	161	167	263		
歸屬於母公司之淨利	435	809	860	-46.2%	-49.4%
每股盈餘(NTD)	1.14	2.11	2.58	-46.0%	-55.8%
重要財務比率					
毛利率	12.24%	15.10%	19.90%		
營業費用率	6.36%	7.32%	5.92%		
營業利益率	5.89%	7.79%	13.98%		
有效稅率	27.01%	17.11%	23.42%		
淨利率	5.69%	9.78%	10.53%		

NTD/百萬元	2Q22	1Q22	2Q21
資產總額	34,043	35,614	32,698
現金及約當現金	3,873	3,711	2,749
短期投資	4	5	5
應收帳款/票據	13,799	14,377	13,403
存貨	3,872	4,822	4,161
固定資產/預付設備款	10,276	10,122	9,569
負債總額	13,092	14,830	17,960
短期借款	2,051	2,494	3,144
應付帳款/票據	5,686	6,644	7,661
長期借款	-	-	1,370
股東權益總額	20,951	20,784	14,738
重要財務指標			
應收帳款週轉天數	151	151	159
存貨週轉天數	64	69	64
應付帳款週轉天數	84	91	102
股東權益報酬率(年化)(%)	13.60	15.73	20.80
資產報酬率(%)	8.42	9.40	10.23
負債比(%)	38.46	41.64	54.93

年度	每股盈餘(NT\$)	股利(NT\$)	現金股利(NT\$)	配息率(%)
2015	1.92	1.6	1.6	83%
2016	3.13	2.5	2.5	80%
2017	4.11	3.1	3.1	75%
2018	5.86	3.8	3.8	65%
2019	8.13	5.0	5.0	62%
2020	8.19	5.0	5.0	61%
2021	9.00	5.0	5.0	56%

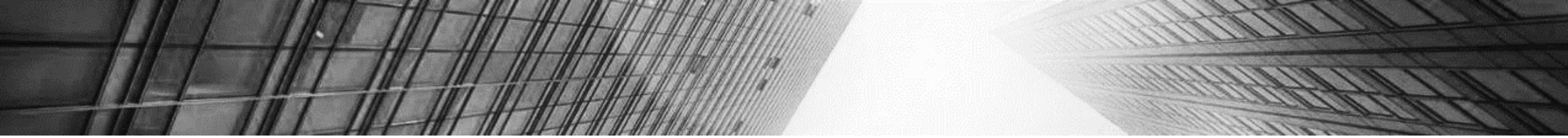
*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股

**於2021年9月2日完成現金增資發行新股5千萬股；目前普通股數約為3.83億股



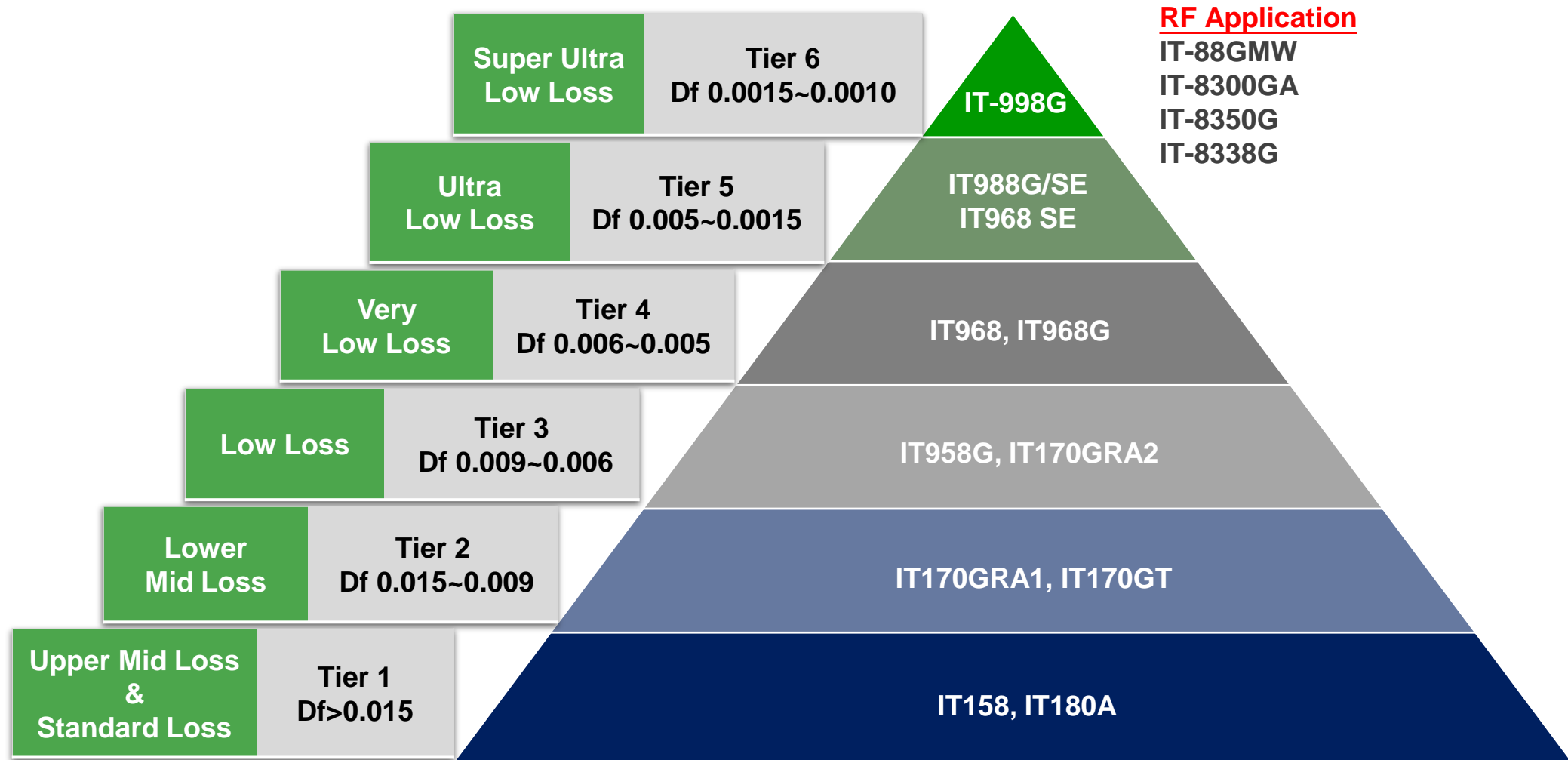
Thank you

Question and Comment



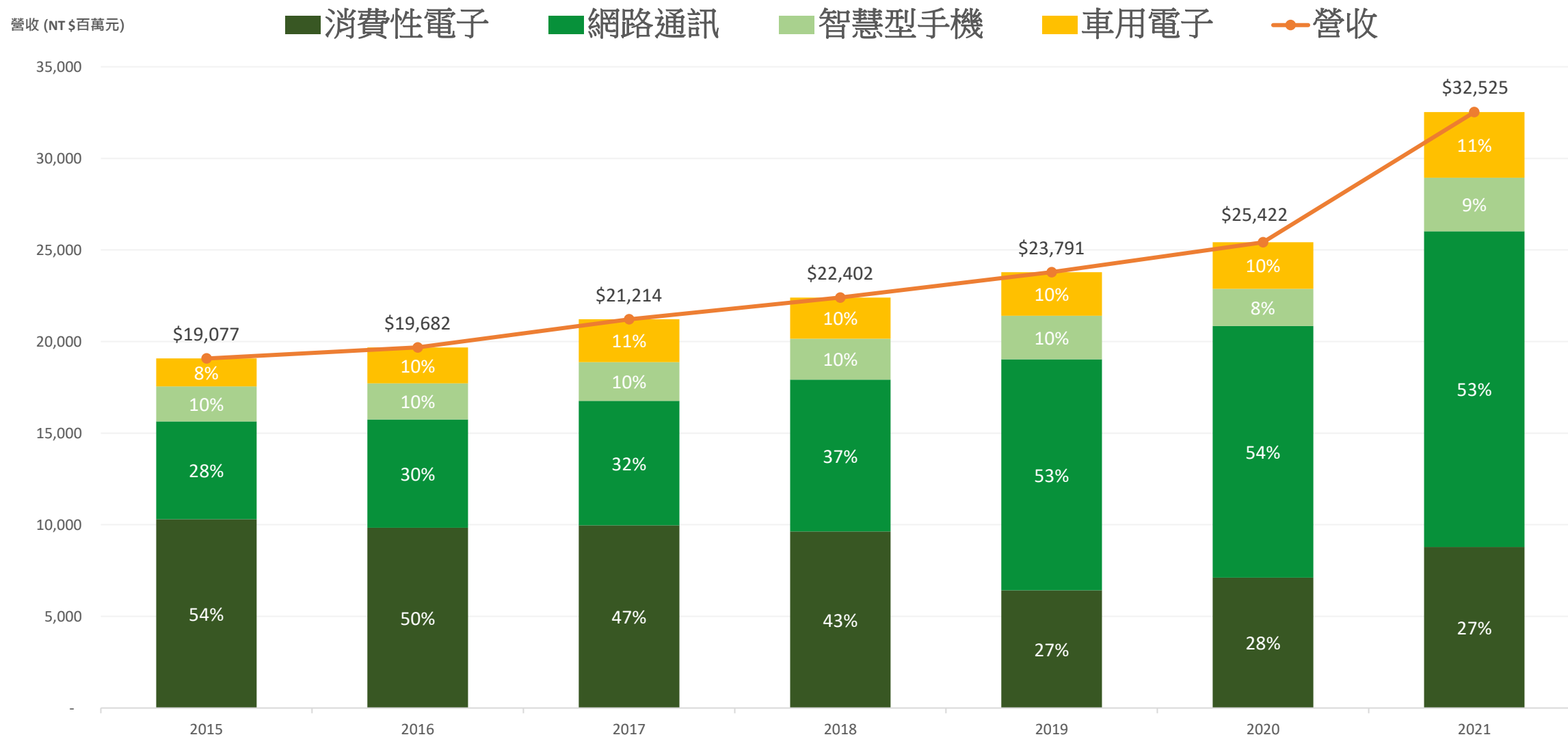
補充附錄

ITEQ



- 隨著5G商用化、伺服器升級等需求，將帶動高頻高速材料需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。

以創新驅動產品組合優化 (2015~2021產品組合)



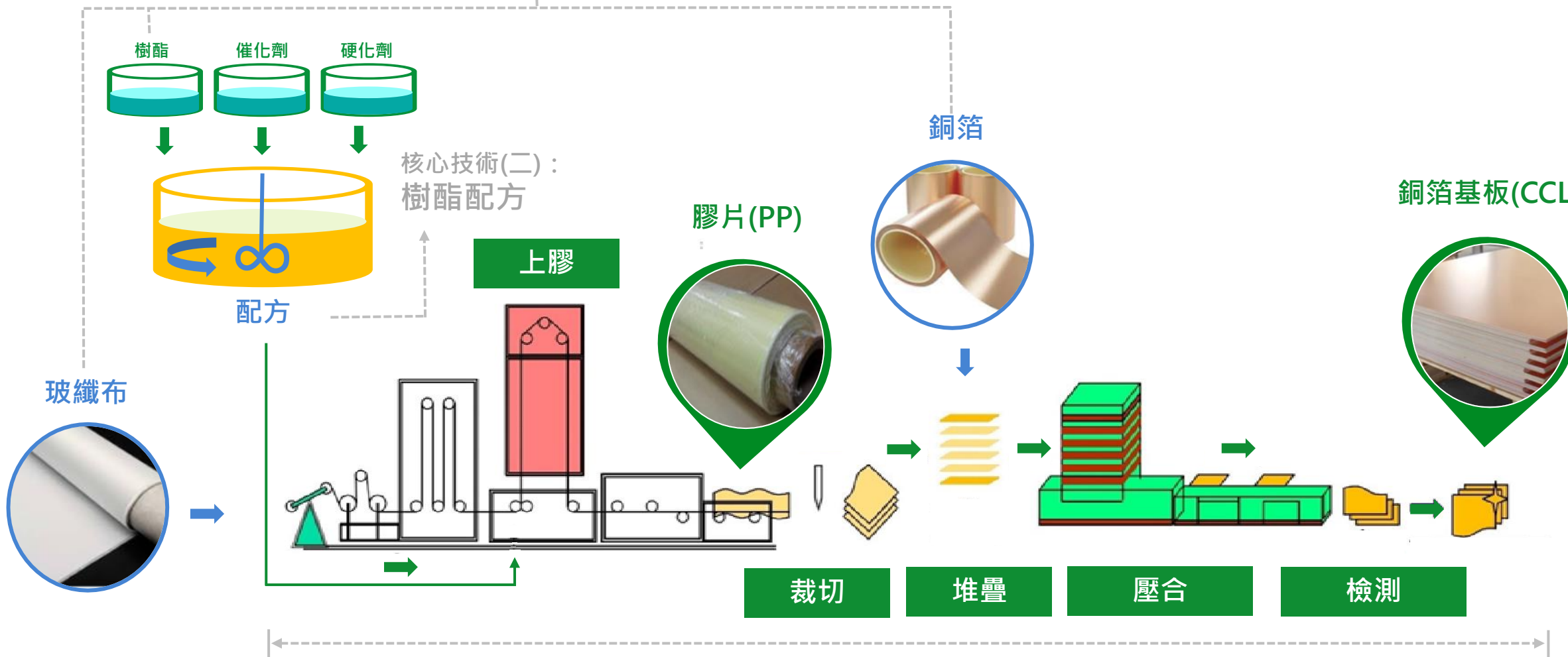
核心技術(一)：材料科學

核心技術(二)：
樹脂配方

膠片(PP)

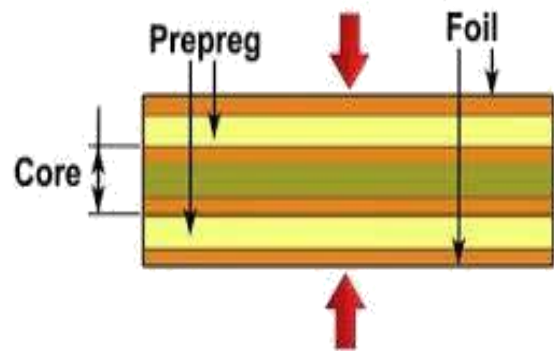
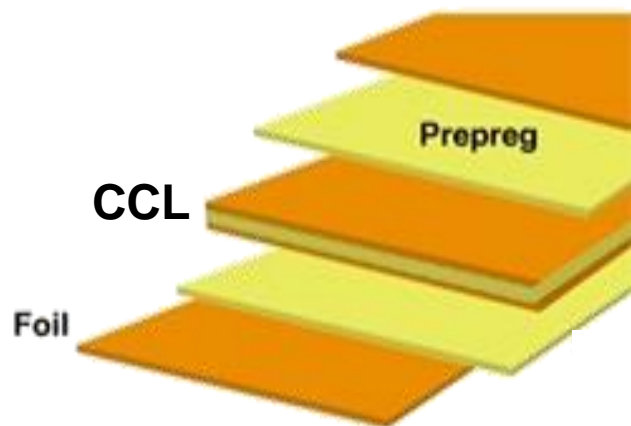
銅箔

銅箔基板(CCL)

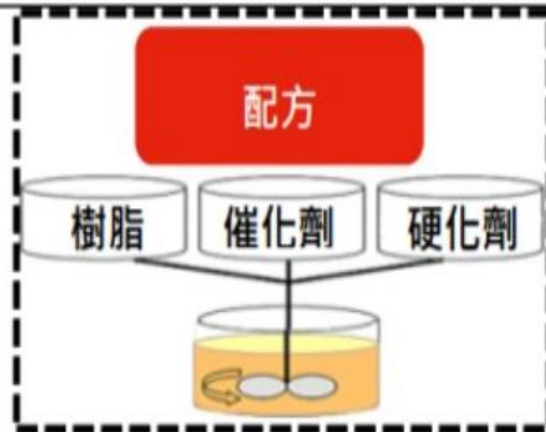


核心技術(三)：製程優化

CCL/PP



CCL 製程圖



玻纖布



銅箔基板



銅箔



PP 黏合

